

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 3 月 3 日 (03.03.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/019298 A1

- (51) 国際特許分類⁷: C08G 59/24 (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/012426
- (22) 国際出願日: 2004 年 8 月 23 日 (23.08.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2003-300473 2003 年 8 月 25 日 (25.08.2003) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ダイセル化学工業株式会社 (DAICEL CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.) [JP/JP]; 〒590-0905 大阪府堺市鉄砲町 1 番地 Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 高井 英行 (TAKAI, Hideyuki) [JP/JP]; 〒739-0651 広島県大竹市玖波 4-4-1 Hiroshima (JP). 前嶋 尚 (MAESHIMA, Hisashi) [JP/JP]; 〒733-0861 広島県広島市西区草津東 1-1 1-2 5-4 O 1 Hiroshima (JP).
- (74) 代理人: 三浦 良和 (MIURA, Yoshikazu); 〒102-0083 東京都千代田区麹町 5 丁目 4 番地 クロスサイド麹町三浦特許事務所 Tokyo (JP).
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書
- 2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: THERMOSETTING EPOXY RESIN COMPOSITION AND TRANSPARENT MATERIAL

(54) 発明の名称: 熱硬化型エポキシ樹脂組成物および透明材料

(57) Abstract: A thermosetting epoxy resin composition is disclosed which is obtained by blending 0.01-20 parts by weight of a cationic polymerization initiator (C) and, if necessary, not more than 50 parts by weight of an acrylic resin having an epoxy group (D) to 100 parts by weight of a composition (E) which is composed of 10-99 weight% of a non-ester alicyclic epoxy compound (A) and 90-1 weight% of another epoxy compound (B) which is different from the compound (A). A cured product of such a thermosetting epoxy resin composition is excellent in heat resistance, dimensional stability and transparency, and therefore serves as an alternative to a glass substrate.

(57) 要約: 本発明は、(A)非エステル型脂環エポキシ化合物10~99重量%、及び、(B)上記(A)と異なるエポキシ化合物90~1重量%からなる組成物(E)100重量部に対し、(C)カチオン重合開始剤0.01~20重量部、及び必要に応じて(D)エポキシ基を有するアクリル樹脂50重量部以下を配合してなる熱硬化型樹脂組成物であり、硬化物は耐熱性、寸法安定性、透明性に優れ、ガラス基板の代替品となる。



WO 2005/019298 A1